

导电系列材料 【无基材导电胶】

品名 型号	厚度 (mm)	垂直阻抗 (ohm/in ²)	适用温度	黏著力 Kg/25mm	基材
HX-1003	0.03T	0.05 Ω ↓	-20~120°C	1.0 ↑	无
HX-1004	0.04T	0.05 Ω ↓	-20~120°C	1.0 ↑	无
HX-1005	0.05T	0.05 Ω ↓	-20~120°C	1.0 ↑	无



产品特性：

使用pe白双离型纸，再使用日本进口导电性压克力感压胶导电系数佳，提供更好的导电性质，具有极佳的粘著性及良好的导通性。

CU系列材料 【导电铜箔】

品名 型号	厚度 (mm)	垂直阻抗 (ohm/in ²)	适用温度	黏著力 Kg/25mm	基材
HX-1106A (CU) 压克力自粘胶	0.065T	0.05 Ω ↓	-20~120°C	1.0 ↑	铜箔
HX-1108A (CU) 压克力自粘胶	0.08T	0.05 Ω ↓	-20~120°C	1.0 ↑	铜箔
HX-1106 (CU) 导电铜箔	0.065T	0.05 Ω ↓	-20~120°C	1.0 ↑	铜箔
HX-1108 (CU) 导电铜箔	0.08T	0.05 Ω ↓	-20~120°C	1.0 ↑	铜箔
HX-1209 (CU) (双面导电)	0.095T	0.05 Ω ↓	-20~120°C	1.0 ↑	铜箔
HX-1312-C (CU MYLAR)					



产品特性：

导电铜箔胶带采用铜箔为基材，电流方面的传导、本铜箔具有低表面氧化之特性，可黏著於各式不同之基材上表现得非常优良，金属、绝缘材料等拥有广宽温度使用范围，具有优越的防电磁波干扰特性。

适用范围：

桌上型及笔记型电脑、扫描器机、液晶显示器、手机、DVD、PDA、PDP、电子业、通讯产品...等。